



### ■ CICMT 2014, Osaka/Japan

Vom 14. bis 16. April 2014 fand die internationale Konferenz ‚CICMT – IMAPS/ACerS 10th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies‘ im Hotel Hankyu Expo Park in Osaka, Japan, statt. Der Expo Park in Osaka entstand zur Weltausstellung Expo 1970. Zeugen dieser Ausstellung sind die Monorail, eine Bahn, die auf einer Betonschiene auf Stützen fährt sowie der Sonnenturm, der als Wahrzeichen im heutigen Landschaftspark verblieb (*Abb. 1*).

Die Beteiligung blieb mit ca. 90 Delegierten und nur fünf Ausstellern weit hinter den Erwartungen zurück. Ursachen dafür waren u.a. die späte Bewerbung der Veranstaltung im Call for Paper und die verspätete Bekanntgabe des Konferenzprogramms. Letzteres führte z. T. zum Rückzug von Präsentationen. Die verzögerte Information an die Sprecher ist auch die Hauptursache dafür, dass Proceedings-Beiträge nur sporadisch eingereicht wurden. Zur Vervollständigung der Proceedings werden nun nachträglich die Beiträge abgefragt, um den Teilnehmern noch eine Tagungs-CD bereitzustellen.

In den sieben einzügigen Sessions lagen die Schwerpunkte auf 3D

Printing and Direct Writing, Ceramic Nanomaterials sowie Prozessierungsaspekten bei der Herstellung keramischer Mikrosysteme. Als Besonderheit zu den Tagungen in den Vorjahren wurden auch Polymer-



Abb. 1: Sonnenturm auf dem Expo-Gelände von 1970 in Osaka; davor ist ein Monorail-Zug zu sehen



Abb. 2: Kinkakuji-Tempel (Goldener Tempel), Kyoto

Keramik-Komposite thematisiert, d. h. Polymere, die man mit speziellen Keramikpulvern funktionalisiert hat. Die deutsche Beteiligung an der Tagung war wie in den Vorjahren vergleichsweise hoch, wohingegen aus den USA nur ein Teilnehmer anreiste. Während der Tagung wurden die Weichen die für CICMT 2015 gestellt. Sie wird im kurzen Wechsel wieder in Deutschland stattfinden. Prof. Michaelis vom Fraunhofer IKTS organisiert mit seinem Team und der Unterstützung von IMAPS die CICMT vom 20. Bis 23. April 2015 in Dresden. Viele Teilnehmer an der Planungsbesprechung setzten sich zudem dafür ein, dass die CICMT 2016 wieder in Denver stattfinden soll.

Nach Abschluss der CICMT gab es für die Teilnehmer die Möglichkeit einer Bustour nach Kyoto, von der insbesondere die europäischen Teilnehmer Gebrauch machten. In einem engen, ca. vierstündigen Programm wurden drei Tempel (Abb. 2) besichtigt und viele



Abb. 3: Abendveranstaltung im Tagungshotel

## ■ Advanced Packaging Conference – The power of packaging

Die SEMI Advanced Packaging Conference wird am 7. und 8. Oktober 2014 in Grenoble in Frankreich (Veranstaltungsort: ALPEXPO Room Belle étoile), stattfinden. Inzwischen liegt das vorläufige Programm vor und wir wollen an dieser Stelle darüber informieren.

*Tuesday, October 7, 2014*

*Session 1– Automotive and Power Packaging*

Chair: Steffen Kroehnert, Director of Technology, NANIUM S.A. - Niederlassung Dresden

13:30 Introduction  
Steffen Kroehnert, Director of Technology, NANIUM

13:40 Keynote – Advanced Packages in Automotive Electronics - the necessary, beloved and hated Components  
Robert Feuerstein, Director, Head of CEP MT, Continental Automotive GmbH

- 14:15 Ultrasonic Heavy Copper Wire Bonding on Silicon Dies with Electroplated Copper Bond Pads  
David Gross, PhD Student, Robert Bosch GmbH
- 14:40 TLS-Waferdicing – The cost efficient high speed alternative for SiC-based semiconductor products  
Hans-Ulrich Zuehlke, Market Development Manager, 3D-Micromac AG
- 15:05 Poster Presentations – Elevator Speeches  
Advanced Stress Analysis on TSV Structures  
Dietmar Vogel, Group Manager, Fraunhofer ENAS
- Silver Sintering – Stieven Josso, Technical Service Engineer, Henkel Electronic Materials
- 3D-printed Interposer as an intermediate layer for the 3D integration of microelectronic components, Thomas Kaiser, CEO, Interposers GmbH
- Process Developments for 3D-IC Integration – Antonio La Manna, Program Manager, imec
- Packaging of integrated optical sensor systems – Falk Steinhof, Key Account Manager, Microelectronic Packaging Dresden GmbH

- New Temporary Bonding Solution Based on a Vacuum Wafer Carrier – Tony Rogers, Technical Director, Applied Microengineering Ltd
- Ag Alloy Wire Characteristic and Benefits – Albert Lan, Senior Director, Siliconware Precision Industries Co., Ltd.(SPIL)

15:33 Coffee Break

*Session 2 – Advanced Packaging Technology and Embedding*

- 16:05 Leading Edge Embedding Technologies Combined: eWLB + ECP® = E2CP  
Steffen Kroehnert, Director of Technology, NANIUM S.A. - Niederlassung Dresden
- 16:30 Application of WDoDTM technology for the manufacturing of SiPs in the medical domain and in the defense and industrial domain  
Jerome Noiray, R&D Engineer, 3D PLUS
- 16:55 Printed Circuit Board (PCB)-based IC Embedding and Package Technology  
Jue Chen, Innovation Manager, Schweizer Electronic AG
- 17:20 Challenges of Flip Chip Packaging with Embedded Fine Line and Coreless Substrate  
Albert Lan, Senior Director, Siliconware Precision Industries Co., Ltd.(SPIL)
- 17:45 Networking Reception

*Wednesday, October 8, 2014*

*Session 3 – Package Design, Material and Process*

- 09:00 Introduction
- 09:10 From Design to Packaging: Necessity & Limitation of Verification & Simulation Tools, Yvon Imbs, Electrical Modeling & Co-design Manager, STMicroelectronics
- 09:35 Plasma dicing, a new technology to improve the overall device manufacturing ecosystem  
Thierry Lazerand, Director Technical Marketing, Plasma-Therm LLC
- 10:00 ST Low cost wire bonding solution : Copper Cu, CuPd and Silver alloy results and strategy down to Ultra Fine Pitch 45 µm BPP (30µm Ball diameter process)

- Eric Perriaud, Wire Bonding Engineer, ST microelectronics
- 10:25 One Material - Two Worlds: Sintering Die Attach on DCB and Leadframe  
Catharina Wille, Senior Engineer Materials, Infineon Technologies AG
- 10:55 Coffee Break
- 11:25 Keynote  
Advanced components packaging in Avionics, challenges and perspectives  
Philippe Pons, Electronics Senior Expert, AIRBUS
- 11:55 Panel discussion  
Packaging in Europe – Future Opportunities  
Moderation Jean-Christophe Eloy  
Panelists:
- Robert Feuerstein, Director, Head of CEP MT, Continental Automotive GmbH
  - Armando Tavares, President and CEO, NANIUM, S.A.
  - Philippe Pons, Electronics Senior Expert, AIRBUS
  - Jean-Marc Yannou, Technica Director, ASE

Info: [http://semiconeuropa.org/ProgramsandEvents/TestandAdvancedPackaging/CTR\\_030446](http://semiconeuropa.org/ProgramsandEvents/TestandAdvancedPackaging/CTR_030446)

**Die Proceedings**

Die des diesjährigen Seminars in Dresden zum Thema ‚Volumenintegration – Stapen, Falten, Vergraben‘, können auf CD zum Preis von 55 € erworben werden.



Die aktuelle CD-ROM enthält neben den 2014er- Proceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigten sich zuvor mit zu Themen wie ‚Medizintechnik – Heraus-

## ■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Helsinki	16.-18. Sept. 2014	ESTC 2014	IEEE CPMT
München	23.-24. Okt. 2014	Herbstkonferenz 2014	IMAPS D
Friedrichshafen	13.-16. Sept. 2015	EMPC 2015	IMAPS Europa, IMAPS D

forderungen an das Packaging<sup>4</sup>, ‚Manche mögen’s heiß – Power Electronic Packaging<sup>4</sup>, oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH,  
Kleingrötzing, 84494 Neumarkt-St.Veit,  
Fax +49 8722 9620-30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

## ■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- Wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- Wir verbinden Wissenschaft und Praxis

- Wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

## ■ Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow  
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit  
und Mikrointegration (IZM)

Head of Dep.: System Integration  
and Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin

Tel +49 30 46403-172 (-270 Sekr., Fax -271)

[martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de](mailto:martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de)

[www.izm.fraunhofer.de](http://www.izm.fraunhofer.de)

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Ernst G. M. Eggelaar, [ee@microtronic.de](mailto:ee@microtronic.de)



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern finden Sie unter [www.imaps.de](http://www.imaps.de) (Vorstand)